

令和3年度

京都実装技術研究会 第2回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第2回例会として、環境規制、低融点はんだの分野から専門の講師の方をお招きしてご講演いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和3年7月13日（火） 13:30 ~ 16:45

◇ 開催方式 Web/会場参加 併用（講師はWebでのご講演です）

◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内容

①「環境規制で変わる実装業界の最新動向

〈新たな環境規制に向けて対処すべき技術と課題〉

特定非営利活動法人日本環境技術推進機構 理事 青木 正光 氏

欧州から環境対応の重要性が指摘されて電気・電子機器に対してRoHS指令が施行され、その後さらに電子機器のみならず広範囲を対象とするREACH規則が欧州で規制されるようになりました。過去から対応した環境規制に、このような環境規制が加わり業界に大きく影響するようになりました。そして鳥瞰すると更なる環境規制が予測されるため、それらの対処すべき技術と課題についても解説します。

②「注目される低融点はんだの進展」

株式会社日本スペリア社 代表取締役 西村 哲郎 氏

はんだ付け時のリフロー温度を例えば200℃に下げることが出来れば、基板組立に関するイメージが大きく変わります。実装部品や装置への負担が軽減されてコストが下がり、環境にもエコだけでなく、実装精度が上がり信頼性も向上できるはずですが、このような活動が遅々として進まない理由に、融点の低いはんだ付けに対する懸念があったからに他なりません。しかし、新たなチャレンジが始まり、状況が一気に変わろうとしています。その活動をサポートする、注目される低融点はんだの進展について解説します。

◇ 定員 Web：応募状況により調整 会場：若干名

◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円
（研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社）

◇ 申込締切 令和3年7月9日（金）まで

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和3年度 京都実装技術研究会 第2回例会申込書

| | | |
|-------|---|----|
| 会社名 | | |
| 所在地 | | |
| 連絡担当者 | 所属・役職 | |
| | 氏名 | |
| | E-mail | |
| | 電話番号 | |
| 参加者 | 所属・役職 | 氏名 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 参加方法 | <input type="checkbox"/> Web 参加 <input type="checkbox"/> 会場参加 | |

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1 事業所 1 接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。